

# decap激光开封机ic去封装芯片反向失效分析

产品名称	decap激光开封机ic去封装芯片反向失效分析
公司名称	仪准科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区软件园广场
联系电话	01082825511-728 13488683602

## 产品详情

### 激光开封机台(Laser Decap)

半导体业的铜制程芯片越来越成为发展主流，这给失效分析中器件开封带来越来越高的挑战。传统的酸开封已经没有办法完成铜制程器件的开封，良率一般低于30%。此时仪准科技推出的激光开封机，给分析产业带来了新的技术。

- 产品特点：
- 1、对铜制程器件有很好的开封效果，良率高于90%。
  - 2、对环境及人体污染伤害较小，符合环保理念。
  - 3、开封效率是普通酸开封机台的3~5倍。
  - 4、电脑控制开封形状、位置、大小、时间等，操作便利。
  - 5、设备稳定，故障率远低于酸开封机台。
  - 6、几乎没有耗材，running cost很低。
  - 7、体积较小，容易摆放。